

第9回

包装材料セミナー

—電子レンジ対応包装技術と包装材料の未来について—

日時：平成26年1月31日(金)
 会場：KFC Room101~103
 主催：公益社団法人日本包装技術協会

ご参加の
お勧め

近年包装材料には、多様化する消費者ニーズから、高機能化・高付加価値化・コスト競争力が求められ、単に内容物の保護だけでなく、加工性から使い勝手、廃棄性等総合的な性能が必要とされています。こうした状況に対応すべく、当会では、日々進化する包装材料の最新動向と今後の展開、業界情報等をご紹介します「包装材料セミナー」を開催しております。第9回目の今回は、電子レンジ対応食品包装に焦点を当て、その最新動向、商品開発事例のご紹介を始め、電子レンジ製造メーカーから包装に対する要望・ご意見等いただきます。また、最後に包装材料全体での現状と今後予想される動向について分析結果をご発表頂きます。どうぞこの機会に関係各位奮ってご参加下さいませようご案内申し上げます。

プログラム

時間	講演内容	講師
10:00 ▼ 11:10	<p>◆『電子レンジ対応食品包装の最新動向』</p> <p>現在、女性の社会進出、シングル生活者の増加、高齢化等の社会変化を背景に、種々のタイプの調理食品の需要が着実に増加している。このような調理食品は、電子レンジで加熱して供されるタイプが主流となっている。調理食品の中で、1食分の主菜や副食等がセットされたタイプのものは、レディミール(ready meal)とも呼ばれている。レディミールはアメリカで開発され、発展してきたが、国内においても開発・販売が活性化してきた。電子レンジ加熱タイプのレディミールの販売形態としては、冷凍販売、冷蔵(チルド)販売、常温販売のいずれもが適用されている。本講演では、電子レンジ加熱タイプの調理食品の各種包装技法(冷蔵・冷凍技法、クイックチル技法、無菌包装・無菌化包装技法、レトルト包装技法、マイクロ派殺菌包装技法)、それらの包装技法に適用されている包材と電子レンジ対応の各種機構、各種開発商品例および今後の市場展望について述べる。</p>	<p>包装科学研究所 主席研究員 葛良 忠彦 氏 コーディネーター 株式会社 エパール事業部 グローバルマーケティンググループ 主管 村田 知規 氏 ユニチカ㈱ フィルムカスタマーソリューション部 技術サービスグループ長 鶴崎 義之 氏</p>
11:20 ▼ 12:30	<p>◆『電子レンジ対応食品の開発のために求められる注意点について』</p> <p>家庭用電子レンジは昭和41年の発売以来、加熱方式やセンサー技術の進化、レンジ出力(効率)のアップを続けてきた。特にここ数年の省エネルギー性の向上には目覚ましい進化がある。また、電子レンジ普及率は90%後半で、その普及率の伸びと同じくして様々な電子レンジ対応食品が開発されている。しかしながら、電子レンジにはそれぞれの機種で異なる加熱特性があり、食品の種類や形状に対して得手不得手がある。このため、今後手軽で早くておいしい電子レンジ対応商品開発の参考となるべく、電子レンジ加熱の仕組みから注意点までを説明する。</p>	<p>三菱電機ホーム機器株式会社 家電製品技術部 調理機器技術一課 課長 金井 孝博 氏 コーディネーター 凸版印刷㈱ 開発販促本部 商品開発部 1部 課長 柴 賢治 氏 ㈱J-オイルミルズ 資材部部长 日高 和弘 氏</p>
12:35 ▼ 13:00	◆講師への質問会	講師 +
13:00 ▼ 13:40	◆昼食休憩	コーディネーター
13:40 ▼ 14:10	<p>◆『レトルト食品の電子レンジ対応技術とプラスチック容器詰めコンビーフの製品化事例の紹介』</p> <p>東洋製罐㈱が開発したレトルト食品の電子レンジ対応技術を紹介する。それとともに最近の商品化例であるオキシガードカップ詰めコンビーフの製品化を詳しく話す。長期保存可能な本製品は電子レンジ加熱可能で、開封性、廃棄性などの利便性が高く評価されている。その製品化事例と製品の商業生産におけるポイントについても報告する。</p>	<p>東洋製罐株式会社 テクニカル本部 基盤技術部 主席 稲葉 正一 氏 コーディネーター 株式会社 エパール事業部 グローバルマーケティンググループ 主管 村田 知規 氏 ㈱J-オイルミルズ 資材部部长 日高 和弘 氏</p>
14:20 ▼ 14:50	<p>◆『電子レンジ調理の安全性を高めた冷凍チルド食品向け蒸気抜きパッケージ』</p> <p>レーザー加工技術を応用した、新たなレンジ調理用蒸気抜き包材を開発した。ミクロンオーダーの微細な蒸気孔が開く機構により、蒸らし効果を持続させ効率的な調理が可能。また、これまで商品化が難しかった汁物、葉物野菜のレシピ開発も可能となる。更に、特殊材料、特殊製袋を要さないため、巻き納め、袋納めともリーズナブルに提供可能。冷凍チルド食品向け包材に広く採用いただくことを可能とした包材である。</p>	<p>凸版印刷株式会社 生活環境事業本部 生活環境製造事業部 商品開発部1チーム 香川 幸子 氏 コーディネーター ユニチカ㈱ フィルムカスタマーソリューション部 技術サービスグループ長 鶴崎 義之 氏 ㈱ロッチ 中央研究所 包装研究室 主管 小垣 美津子 氏</p>
15:00 ▼ 16:00	<p>◆『食品包装を取り巻く現状と今後の展望』</p> <p>食品包装は、社会状況やライフスタイルの変化の中で「国民に必要とされる技術」として多方面の研究・開発が行われ、世界で起こった多くのイノベーションを吸収しつつこれまで発展してきました。近年、「Save food!」のスローガンの元、食品の輸送・販売段階において発生している大規模な食品の無駄削減のためには包装を改善する必要があるということが再認識され、アクティブパッケージ、インテリジェントパッケージなど様々な高機能包材の開発が期待されているところです。一方、農林水産省が示す食品産業の将来ビジョンにおいて、食品産業が将来にわたって持続的に事業活動を展開していくためには、従来の生産を起点とした発想ではなく、需要サイドに立った新しい付加価値を提供することにより、国内市場の深耕とアジアの新興国等を主な対象とする海外市場の開拓を戦略的に進めていくことが重要であるとしています。本講演では、これらの視点から食品包装について考えてみたい。</p>	<p>独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所 企画管理部 業務推進室長 石川 豊 氏 コーディネーター 東洋製罐㈱ テクニカル本部 プラスチック技術部 加工技術グループ 主任部員 山口 裕司 氏 アサヒ飲料㈱ 研究開発本部 技術研究所長 安部 寛 氏</p>
16:05 ▼ 16:30	◆講師への質問会	講師 +
		コーディネーター

講師のご紹介

葛良 忠彦氏

包装科学研究所 主席研究員

【ご略歴】
 1965年 3月 京都大学工学部高分子化学科卒業
 1971年 3月 京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻 博士課程 修了
 同年 4月 東洋製罐株式会社 東洋製罐グループ総合研究所 第3研究室 勤務
 1983年 12月 McGill大学(カナダ)化学工業科 Prof.Kmal研究室 研究員(Post Doctoral Fellow)(1年職)
 1989年 7月 東洋製罐グループ総合研究所 調査企画室 室長
 2003年 4月 東洋製罐株式会社 定年退職
 2004年 5月 包装科学研究所 主席研究員
 【関連学協会】 プラスチック成形加工学会 評議員、日本包装学会 評議員、学会賞選考委員、SfPE (Society of Plastics Engineers)日本支部 理事、日本合成樹脂技術協会 理事

金井 孝博氏

三菱電機ホーム機器株式会社
家電製品技術部
調理機器技術一課 課長

【ご略歴】
 1987年 三菱電機ホーム機器株式会社 入社
 電子レンジ設計担当として、新規開発モデルの設計を行う
 現在に至る

稲葉 正一氏

東洋製罐株式会社
テクニカル本部
基盤技術部 主席

【ご略歴】
 1984年 東洋製罐株式会社 入社
 東洋製罐グループ総合研究所へ配属
 カップの充填技術の開発、電気応用技術の研究
 2004年 東洋製罐株式会社 開発本部 カスタマーソリューションシステム部 充填技術開発グループ
 2012年 東洋製罐株式会社 テクニカル本部 基盤技術 主席
 現在に至る

香川 幸子氏

凸版印刷株式会社
生活環境事業本部
生活環境製造事業部 商品開発部1チーム

【ご略歴】
 1998年 凸版印刷株式会社 入社、以降現在に至るまでパッケージ商品の開発に従事
 弊社のハイバリアフィルム(GLフィルム)の開発から、医薬包材、非食品包材を担当し、現在の食品包材開発に至る
 特にレーザー加工技術を用いた商品化については、現在グループ体制で重点テーマの位置づけで取り組んでいる

石川 豊氏

独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構
食品総合研究所 企画管理部 業務推進室長

【ご略歴】
 1987年 4月 農林水産省食品総合研究所 農学博士取得(東京理工大学)
 1993年 3月 筑波大学農林工学系助教授
 1999年 6月 独立行政法人食品総合研究所流通安全部食品包装研究室主任研究官
 2002年 7月 農林水産省農林水産技術会議事務局 研究調査官
 2003年 10月 (現)農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所食品工学研究領域 食品包装技術ユニット・ユニット長
 2006年 4月 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所企画管理部 業務推進室長
 2014年 4月

開催要領

日時:平成26年1月31日(金)
 会場:KFC Room101~103
 東京都墨田区横綱1-6-1 TEL. 03-5610-5801
 参加費:会員 17,850円(消費税5%・テキスト代含む)
 *同時に3名以上でお申込みの場合には
 割引価格として1名14,700円
 一般 26,250円(消費税5%・テキスト代含む)
 定員:100名

お申し込み方法

- 本紙申込書に必要事項を全てご記入の上、FAXにてお申込み下さい。
 協会HPからのお申し込みも出来ます。
 協会HP:<http://www.jpi.or.jp>
- 申込みされた方には、後日参加証と請求書をお送りします。
- 開催1週間前からの参加費の払い戻しは致しません。申込みされた方がご都合の悪い場合、代理の方の出席は差し支えありません。
 (当日、名刺をご提出いただきます。)

お問い合わせ並びにお申込み先

公益社団法人日本包装技術協会 包装材料セミナー係
 担当:竹内
 〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル10F
 TEL. 03(3543)1189 FAX. 03(3543)8970
 e-mail:takeuchi@jpi.or.jp

会場案内図

地下鉄

●都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出入口に直結

JR

- JR中央・総武線「両国駅」東口より徒歩約6分
 東口改札より線路沿いを千葉方面へ向かい、突き当たり大通りを左折しガードをくぐり、約200m先左手25階建てビル
- JR中央・総武線「両国駅」西口より徒歩約7分
 西口改札より両国国技館と江戸東京博物館の間の歩行者用通路に沿って、車止めのある十字路を右折
 両国中学校と江戸東京博物館の間のレンガ道を進み大通りを左折し、約50m先左手25階建てビル



【個人情報取り扱いについて】

1. 個人情報は「第9回包装材料セミナー」の事業実施に関する資料等の作成、並びに当会が主催・実施する各事業におけるサービスの提供や事業のご案内のために利用させていただきます。なお、作成資料は開催当日、関係者に限り配布する場合があります。
2. 参加申込みによりご提供いただいた個人情報は、法令に基づき場合などを除き、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

第9回包装材料セミナー(1月31日開催)参加申込書

公益社団法人日本包装技術協会 竹内 行 FAX.03(3543)8970 No.

会社名					
所在地	(〒)				
電話			FAX		
参加者名	氏名	所属役職		e-mail	
	氏名	所属役職		e-mail	
	氏名	所属役職		e-mail	